

2025年6月23日

「九州・沖縄地銀連携協定（Q-BASS）」×京セラ株式会社の 『半導体製造装置部品切削加工ソリューションセミナー』 共同開催について

株式会社福岡銀行（取締役頭取 五島 久）が参加する、九州・沖縄地銀連携協定（以下「Q-BASS」^{キューベース}）は、京セラ株式会社との共催により、『半導体製造装置部品切削加工ソリューションセミナー』を6月20日（金）に福岡銀行本店営業部にて開催しました。

本イベントには、半導体製造装置部品の加工を担う企業をはじめ、43社/91名（オンライン参加者を含む）が参加しました。

イベントの第1部では、切削加工の活用事例と、京セラ株式会社の最新加工ソリューションや最新サービスの紹介、第2部では、ネットワーキング・加工技術相談会を開催し、参加企業間の情報交換や交流を深める場を提供しました。

福岡銀行は今後も、Q-BASSの活動を通じて「新生シリコンアイランド九州」の実現を目指し、協定参加の13行が相互に連携・協力することで、九州・沖縄・山口経済のさらなる成長に貢献してまいります。

イベント風景



〈開講挨拶〉



〈第1部セミナー〉



〈第2部ネットワーキング・加工技術相談会〉



〈第2部ネットワーキング・加工技術相談会〉

以上

《 本件に関するお問合せ先 》

(株)福岡銀行 ソリューション営業部 半導体戦略室

担当：右田、江口、千々和 TEL 092-723-2525